

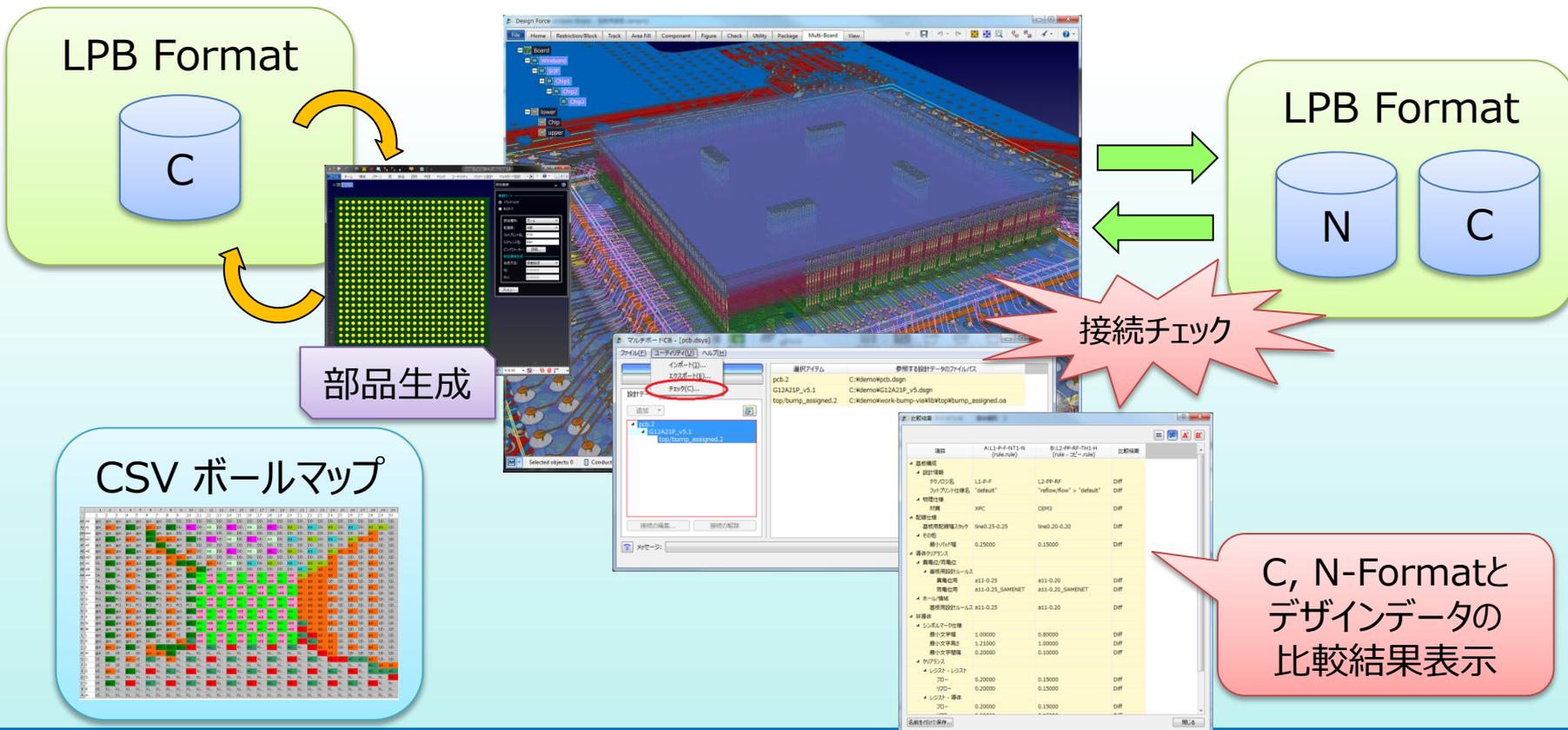
CR-8000 Design Force LPBフォーマットの対応状況

株式会社図研
EDA事業部
2015/3/19



LPBを用いたシステムレベルコデザインの機能拡張

- LPBを用いてLSI/PKG/Board間をシームレスに連携
 - LSI/PKG/Board間の接続をバージョン毎に管理
 - 様々なEDA環境と連携しながらシステム全体の最適化と検証が可能に
 - LSI/PKG/Board間の情報伝達を容易に



C, N-Formatと
デザインデータの
比較結果表示

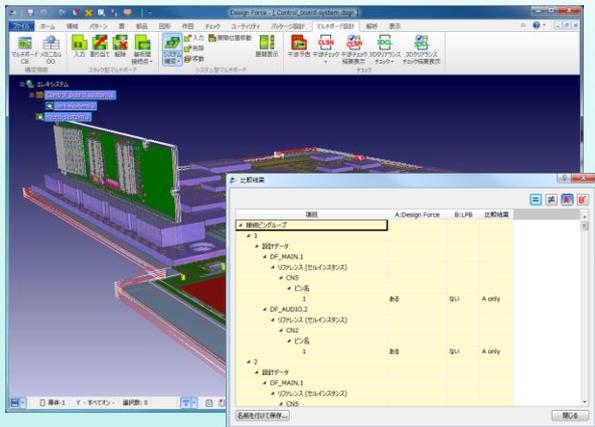
LPBを用いたシステムレベルコデザインの機能拡張

- LPBを用いたシステムレベル接続比較
 - LPBフォーマットでLSI/PKG/Board間の接続情報を比較結果表示

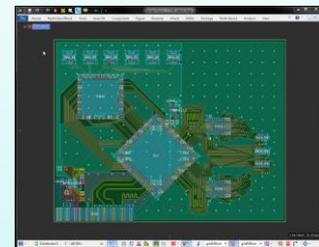


標準フォーマットでの出力/比較機能により
システムレベル設計検証の効率向上

システムレベルの接続情報をLPBフォーマットで出力します。



システムレベルの接続が変更された場合、変更された箇所を簡単に比較することができます。

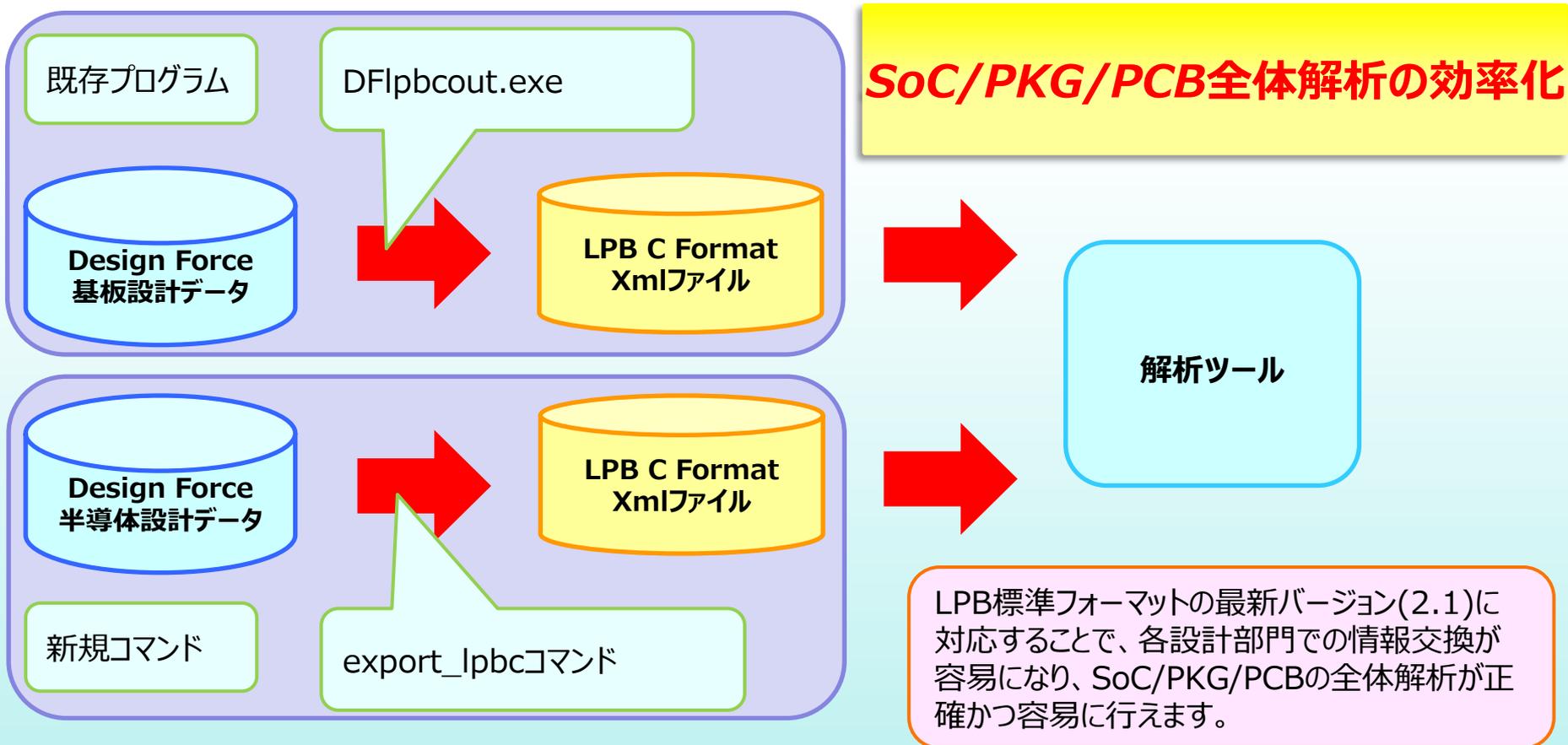


LPBフォーマットを出力/比較することで、LSI-PKG-Boardの設計検証作業を容易にします。

LPBを用いたシステムレベルコデザインの機能拡張

• LPB-Cフォーマット出力

- LPB-CフォーマットのVer.2.1に対応しました。
- 半導体設計データからもLPB-Cフォーマットを出力できるようにしました。



LPBを用いたシステムレベルコデザインの機能拡張

LPB-Cフォーマットからの部品登録

- LPB-Cフォーマットからの部品登録
 - 部品登録機能において、LPB-Cフォーマットから部品が生成できるようになりました。

**LPB標準フォーマット対応により
部品情報交換の効率が向上**

LPB-Cパラメーター

LPB-Cフォーマットファイル名: D:\sample\sample.xml

LPB-Cフォーマットソケット名: SOC_PKG

登録モード
 パラメトリック
 BGA-F
 LPB-Cフォーマット

ミラー反転: 実装方法:
 パッド層:
 部品形状: ボール 部品の底辺:
 部品の厚み:

ピン数: 276

部品の設定:

X座標	Y座標	角度	ピン番号	ネット名	信号タイプ	パッドスタック				
						形状	幅	高さ	角度	名称
12.50000	12.50000	0.00000	A1	NC1		円形	0.50000			
11.50000	12.50000	0.00000	A2	NC2		円形	0.50000			
10.50000	12.50000	0.00000	A3	VDD_CORE	POWER	円形	0.50000			
9.50000	12.50000	0.00000	A4	VDD_GPIO	POWER	円形	0.50000			
8.50000	12.50000	0.00000	A5	FKBDO[5]	I/O	円形	0.50000			
7.50000	12.50000	0.00000	A6	FKBDO[2]	I/O	円形	0.50000			
6.50000	12.50000	0.00000	A7	VDD_GPIO	POWER	円形	0.50000			
5.50000	12.50000	0.00000	A8	VDD_PLL	POWER	円形	0.50000			
4.50000	12.50000	0.00000	A9	XTAL1	I/O	円形	0.50000			
3.50000	12.50000	0.00000	A10	VDD_DDR	POWER	円形	0.50000			
2.50000	12.50000	0.00000								
1.50000	12.50000	0.00000								

LPB-Cフォーマットを読み込んだ後、パラメーターの変更も可能です。

LPBを用いたシステムレベルコデザインの機能拡張

- LPB-Format対応状況

LPB	N	C	R	G
入力	○(※1)	○(※2)	×	×
出力	○	○(※2)	×	○

※1 チェックのみ

※2 端子情報のみ

- 今後の開発予定

- C-Formatのコンストレインツ情報の入出力
- R-Formatの入出力